



フォト成型樹脂 Photoimageable Molding Resin

ネガ型化学増幅型オキセタン系の成型用樹脂

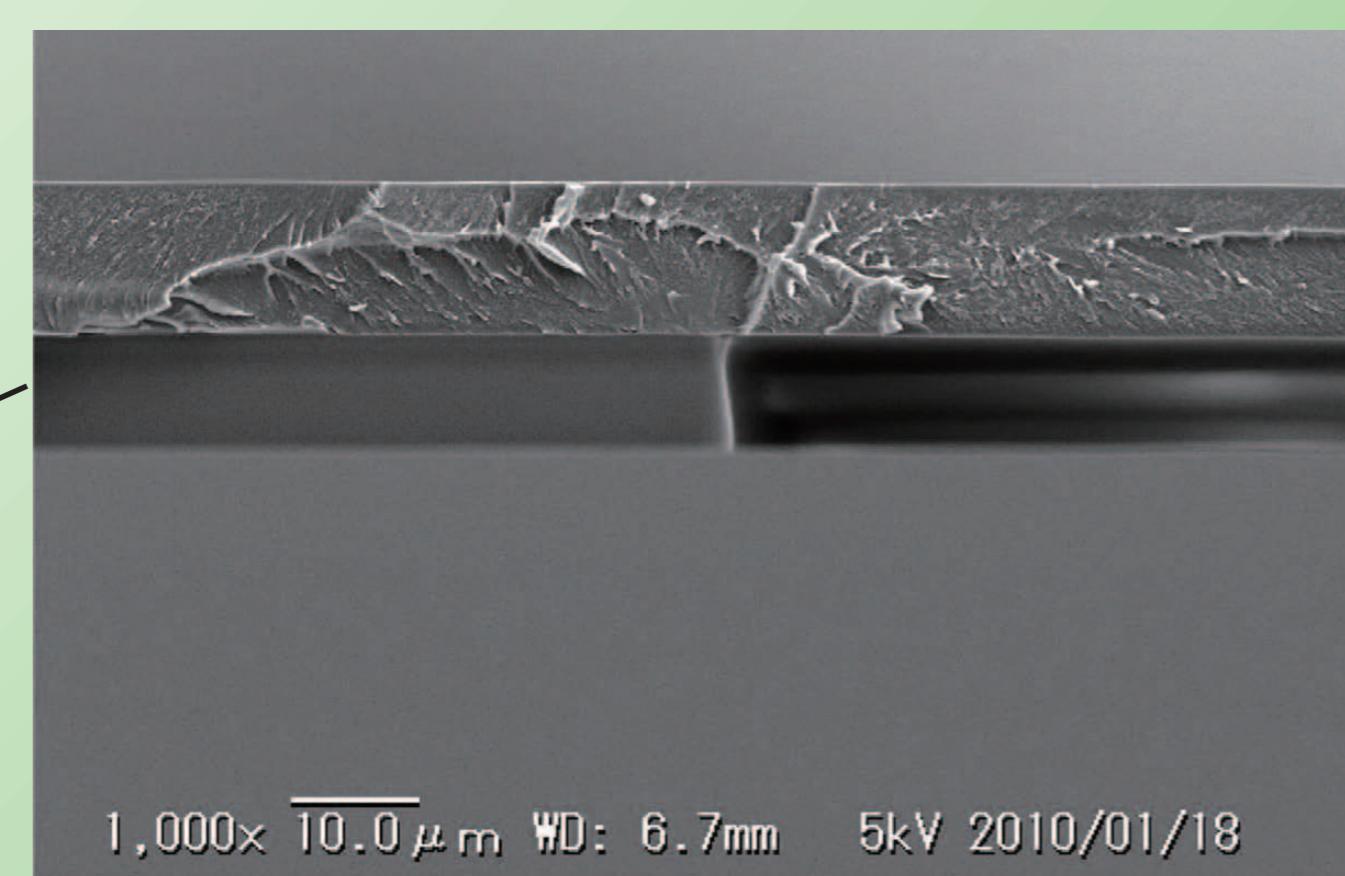
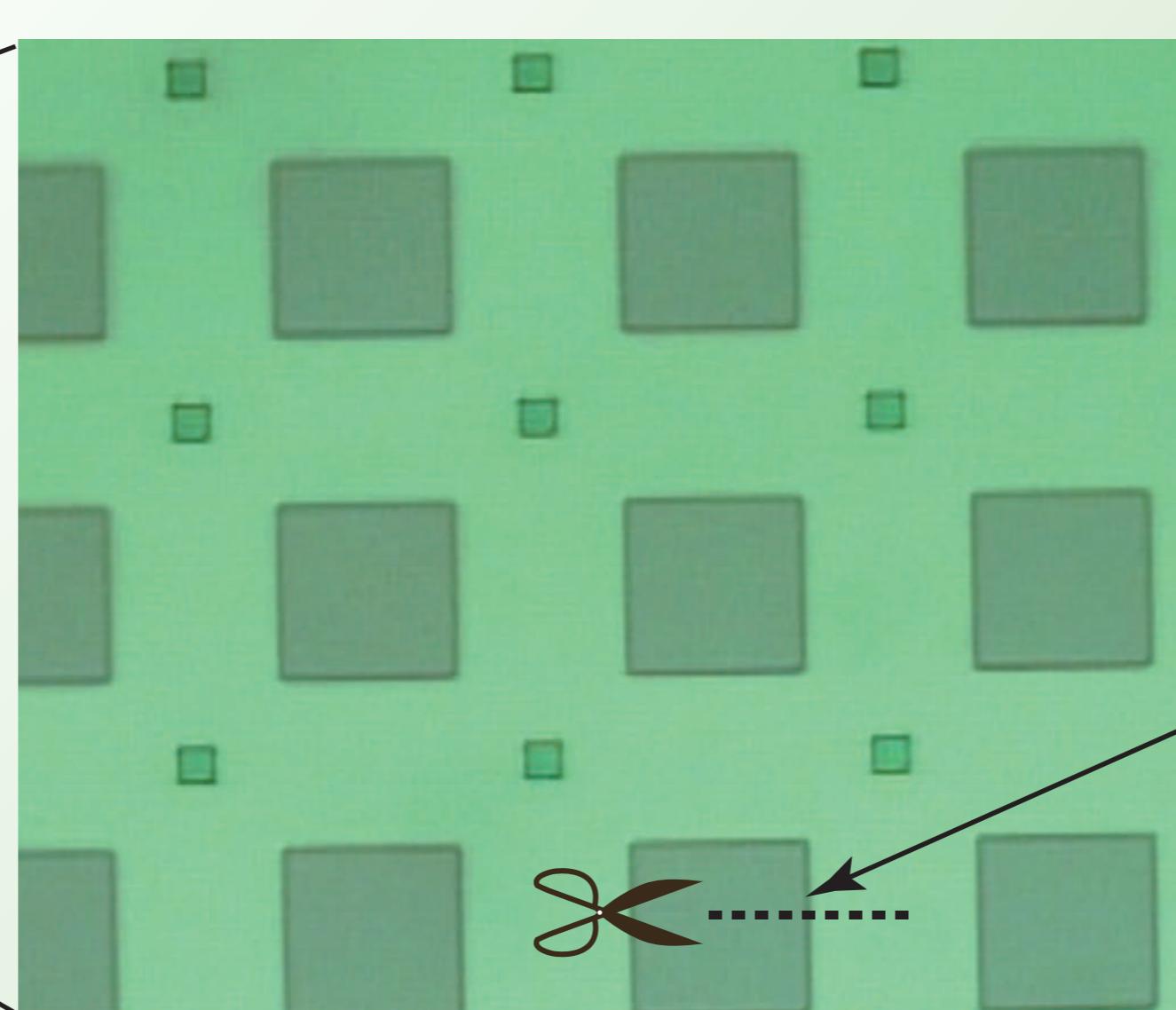
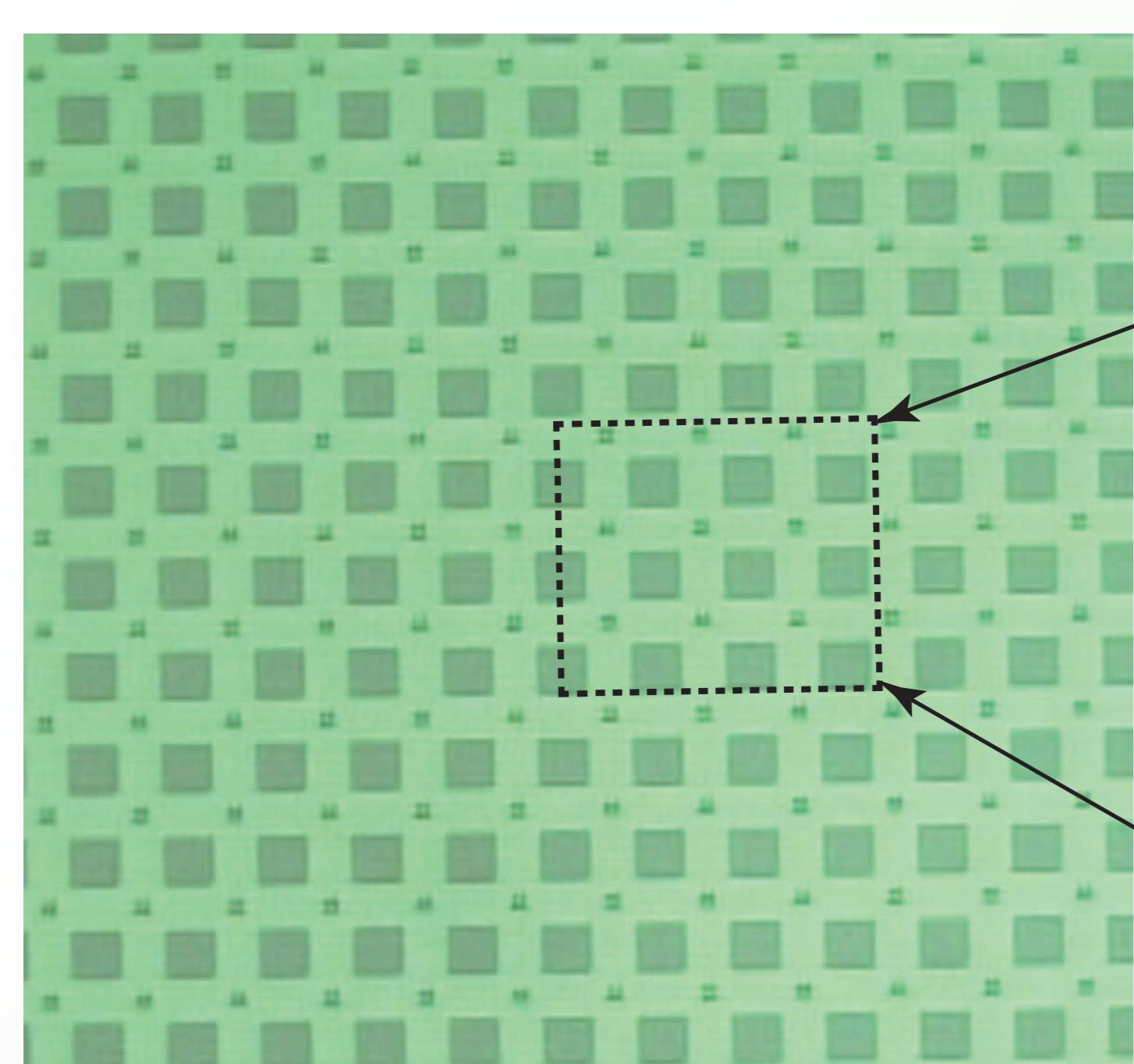
Negative type, chemical-amplified oxetane molding resin

- i線 (365nm) を中心とした感光域 Photo-sensitive spectrum (center : i-line 365nm)
- 極性の低い溶剤を使用しているため未硬化樹脂の上に形成可能
Low-polarity solvent for use on surface of uncured resin
- エポキシ系に比較して、高分子量化するため強靭な成型物が得られる
Tougher molding material due to higher molecular mass compared with epoxy cure type
- 低金属イオン (1ppm 未満)
Low metal ion (under 1ppm)
- 耐熱性、耐薬品性に優れる
Excellent heat resistance and chemical resistance

プロセス Process



スピンコート Spin-coater
80°C, 5 分 (ホットプレート) 80°C, 5min. (on hot-plate)
800mJ/cm²
80°C, 1 分 (ホットプレート) 80°C, 1min. (on hot-plate)
専用現像液 (溶剤系) パドル等
Special developer (solvent type), paddle, etc.
IPA
加熱、UV 照射等 Thermal cure or UV cure



TAIYO INK MFG. CO., LTD.